



PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

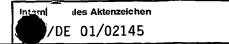
(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Mitteilung über o Recherchenberichts (F	die Übermittlung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit			
R. 38571 Kut/Hx	VORGEHEN	zutreffend, nachsteher	nder Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmel (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/DE 01/02145	07/06/2	001	11/07/2000			
Anmelder						
ROBERT BOSCH GMBH						
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	de von der Internationale ternationalen Büro überi	en Recherchenbehörde e mittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht umf	aßt insoesamt 3	_ Blätter.				
Darüber hinaus liegt ihm jer	weils eine Kopie der in d		n Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts						
A. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eine	ernationale Recherche a gereicht wurde, sofern u	uf der Grundlage der inte nter diesem Punkt nichts	ernationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.			
	ne ist auf der Grundlage		ngereichten Übersetzung der internationalen			
b. Hinsichtlich der in der internationale	en Anmeldung offenbarte	en Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenz ist die internationale			
Recherche auf der Grundlage des in der internationalen Anme	Sequenzprotokolls durch	igeführt worden, das				
zusammen mit der internati			ngereicht worden ist.			
. —						
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
Die Erklärung, daß das nac internationalen Anmeldung	chträglich eingereichte so im Anmeldezeitpunkt hi	chriftliche Sequenzprotok nausgeht, wurde vorgele	koll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.			
			m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rech	nerchierbar erwiesen (s	siehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe l	Feld II).				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfi	ndung					
X wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut gene	hmigt.				
wurde der Wortlaut von der	r Behörde wie folgt festg	esetzt:				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
wird der vom Anmelder ein wurde der Wortlaut nach R Anmelder kann der Behörd Recherchenberichts eine S	legel 38.2b) in der in Fel de innerhalb eines Mona	d III angegebenen Fassuts nach dem Datum der /	ung von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfa	ssung zu veröffentlichen				
wie vom Anmelder vorgeso	-		keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst k						
weil diese Abbildung die E	rfindung besser k nnzei	chnet.				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

	·		DE 01/ 02143
a. klassi IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01K7/02 G01J5/12		
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo G01K G01J H01L	ole)	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die rec	cherchierten Gebiete fallen
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, WPI Data	ame der Datenbank ui	nd evtl. verwendete Suchbegriffe)
C. ALC ME	SCENT IOU ANGEGEVENE UNITED AGEN		
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	n der in Batrocht komm	ander Tella Betr Asserteb No.
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabo	e der in Beirachi komm	enden Teile Betr. Anspruch Nr.
Α	US 5 220 189 A (HIGASHI ROBERT E 15. Juni 1993 (1993-06-15) Spalte 5, Zeile 30 - Zeile 68; Ab	-	1,6
Α	WO 91 02229 A (BRAUN AG) 21. Februar 1991 (1991-02-21) Zusammenfassung; Abbildungen		1,2
А	FR 1 204 718 A (J. MICHEL) 27. Januar 1960 (1960-01-27) Abbildung 1		1,6
Α	US 5 695 283 A (JOHNSON BRUCE C) 9. Dezember 1997 (1997-12-09) Spalte 4, Zeile 31 - Zeile 57; Ab	bildung 2	1
	-	-/	,
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang	y Patentfamille
"A" Veröffer aber n "E" älteres	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	oder dem Prioritäts Anmeldung nicht k	chung, die nach dem internationalen Anmeldedatum sdatum veröffentlicht worden ist und mit der collidiert, sondern nur zum Verständnis des der eliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden n ist
Anmel *L* Veröffer schein andere	dodatum voröffantlight warden ist	"X" Veröffentlichung vo kann allein aufgrur erfinderischer Tälig "Y" Veröffentlichung vo	n besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung id dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf gkeit beruhend betrachtet werden in besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
ausge 'O' Veröffe eine B 'P' Veröffe	führt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationaten. Anmeldedatum, aber nach	werden, wenn die Veröffentlichungen diese Verbindung	erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen o dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und für einen Fachmann naheliegend ist ie Mitglied derselben Patentfamille ist
-	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum de	s internationalen Recherchenberichts
2	9. August 2001	06/09/2	2001
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter E	Bediensteter
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Ramboer	·, p

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



		/DE 01/02145
C.(Fortsetz Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend	en Teile Betr. Anspruch Nr.
Raiegone	Dezeroillung der Verbilentikoliding, somek choldental and rungass as in section	
А	EP 0 999 437 A (OPTO TECH CORP) 10. Mai 2000 (2000-05-10) Spalte 6, Zeile 5 - Zeile 9; Abbildungen	1,4
A	GERWEN VAN P ET AL: "THIN-FILM BORON-DOPED POLYCRYSTALLINE SILICON 70%-GERMANIUM 30% FORTHERMOPILES" SENSORS AND ACTUATORS A, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, Bd. A53, Nr. 1/3, 1. Mai 1996 (1996-05-01), Seiten 325-328, XP000620316 ISSN: 0924-4247 das ganze Dokument	6,8,10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung...,

selben Patentfamilie gehören

Intern	es Aktenzeichen	
	DE 01/02145	

lm Recherchenbericl ngeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		tglied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5220189	Α	15-06-1993	EP WO	0645056 A 9326053 A	29-03-1995 23-12-1993
WO 9102229	Α .	21-02-1991	DE DE DE EP	3925391 A 4091364 A 4091364 D 0485401 A	07-02-1991 30-01-1992 30-01-1992 20-05-1992
FR 1204718	Α	27-01-1960	CH DE	337888 A 1205598 B	30-04-1959
US 5695283	Α	09-12-1997	KEIN	E	
EP 0999437	Α	10-05-2000	KEIN	E	



Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die

Vom meldeamt auszufüllen Internationales Aktenzeichen	
Internationales Anmeldedatum	
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)	

internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird	Name des Anmeldean	nts und "PCT International Application"
	Aktenzeichen des Ans (max. 12 Zeichen) R	nelders oder Anwalts <i>(falls gewünscht)</i> . 38571 Kut/Hx
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Mikromechanischer Thermosensor		·
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Person amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist doder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzangegeben ist.)	Name des Staats Ier Staat des Sitzes	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Telefonnr.:
DODERE BOCCU CMDU		0711/811-23062
ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20		Telefaxnr.:
70442 Stuttgart		0711/811-331 81
Bundesrepublik Deutschland (DE)	•	Fernschreibnr:
Bundesrepublik bedeseniand (bil)		remsement.
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten alle Bestimmun Ausnahme der V Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) E	ereinigten Staaten	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname, bei juristischen Person amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes od angegeben ist.) PANNEK, Thorsten Hasenbergstraße 99 70176 Stuttgart DE	Name des Staats an- Staat des Sitzes oder der Wohnsitzes	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten Ausnahme der V Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem F Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER;	ereinigten Staaten Cortsetzungsblatt angege	
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für de	en (die) Anmelder	Anwalt gemeinsamer
vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft	zu handeln als:	Vertreter Vertreter
Name und Anschrift (Familienname, Vorname, bei juristischen Person amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die des Staats anzugeben)		Telefonnr.: Telefaxnr.:
		Fernschreibnr:
Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	neinsamer Vertreter best	ellt ist und statt dessen im obigen Feld

EV003625615US

Blatt Nr		<u> </u>
Fortsetzung von Feld Nr. III WEIT ANMELDER UND/ODER	(WEITERE) ERF	€ <i>R</i>
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so is	t dieses Blatt dem An	ntrag nicht beizufügen.
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Nar zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Sta Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder angegeben ist.)	Diese Person ist	
TRAH, Hans-Peter		N
Kullenbergstraße 40		Anmelder und Erfinder
70195 Stuttgart	•	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen
DE		angekreuzt, so sind die nach- stehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz	
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- nungsstaaten alle Bestimmungsst Ausnahme der Vere		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Nanzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Sta Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder angegeben ist.)	ne des Staats an- at des Sitzes oder	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nach-
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz	stehenden Angaben nicht nötig.) (Staat):
	<u> </u>	
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten Ausnahme der Vere		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname, bei juristischen Personen amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Nazugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Sta Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder angegeben ist.)	ne des Staats an- at des Sitzes oder	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz	
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstraten alle		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Natzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Sta Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder angegeben ist.)	vollständige me des Staats an- aat des Sitzes oder	Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz	
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungssi	taaten mit	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld
für folgende Staaten: ungsstaaten Ausnahme der Vere		Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortse		
Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt)	Sie	he Anmerkungen zu diesem Antragsformular

		BESTIMMUNG VON STAATEN .			
		den Bestimmungen nach P.4.9 Absatz a werden hiermi	it vorg	enomn	nen:
Regi		Patent	•		
	AP	ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia			
1					it, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
	EΑ	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidsch			
1		Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikista	an, TN	/I Turk	kmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat
		des Eurasischen Patentübereinkommens und des PC			
$ \boxtimes$	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien,			
		DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Fi			
1	•	GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxe			
1		SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaa		_	
	OA				
	•	CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea			
					ler OAPI und des PCT ist
Natio		Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ver	rjahrer		
1		Vereinigte Arabische Emirate	닖.		Liberia
닏	АĻ	Albanien	Щ	LS	Lesotho
I∐	AM	Armenien		LT	Litauen
	ΑT	Österreich		LU	Luxemburg
	ΑU	Australien			Lettland
		Aserbaidschan	$\overline{\Box}$		Republik Moldau
lП	BA		Ħ		Madagaskar
	BB	Barbados	H		
H		_ ··· _ · · · _ ·	ш	WIK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
닏		Bulgarien			
IĽ		Brasilien	Щ		Mongolei
IJ	BY	Belarus	\Box	MW	Malawi
	CA	Kanada		MX	Mexiko
	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein		NO	Norwegen
	CN	China		NZ	Neuseeland
	CU	Kuba	\sqcap	PL	Polen
	CZ	Tschechische Republik.	百	PT	Portugal
ıĦ	DE	Deutschland	\vdash	RO	Rumänien
lH.		Dänemark	\vdash		
			H	RU	Russische Föderation
	EE	Estland	\vdash	SD	Sudan
	ES	Spanien	\vdash	SE	Schweden
	FI	Finnland	\sqsubseteq	SG	Singapur
		Vereinigtes Königreich	\sqcup	SI	Slowenien
	GD	Grenada		SK	Slowakei
	GE	Georgien		SL	Sierra Leone
	GH	Ghana		TJ	Tadschikistan
	GM	Gambia	\sqcap	TM	Turkmenistan
ΙΠ		Kroatien	Ħ	TR	Türkei
lΗ	HU	Ungarn	H	TT	Trinidad und Tobago
lH		Indonesien	H		2
lH	ID			UA	Ukraine
쁘	IL	Israel	닏	UG	Uganda
l H	IN	Indien	\bowtie	US	Vereinigte Staaten von Amerika
I∐	IS	Island			
$ \boxtimes $	JP ·	Japan		UZ	Usbekistan
	KE	Kenia		VN	Vietnam
ΙΠ	KG	Kirgisistan	\sqcap	YU	Jugoslawien
ΙĦ	KP	Demokratische Volksrepublik Korea.	H	ZA	Südafrika
	444	Demokratische vorksrepublik Rolea	H		
	I/D		L Käst-	ZW	Simbabwe
		Rebublik Korea			r die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der
닏	KZ	Kasachstan	v eröi	rrentiic	hung dieses Formblatts beigetreten sind:
닏	LC	Saint Lucia	\Box		
	LK	Sri Lanka			
Erklä	rung b	zgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben gena	nnten F	Restima	nungen nimmt der Anmelder nach Regel 4 9 Absatz hauch alle

anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen -unter dem Vorbehalt einer Bestätigung siehen und jede zusätzliche Be-stimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt2) (Juli 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

		Blatt Nr4		₹ \$2°-17
Feld Nr. VI PRIORITÄTSA	NSPRUCH		eitere Prioritätsansnrüche si	nd im Zusatzfeld angegeben
Anmeldedatum	A sichen der	<u> </u>	Ist die f	
•	frül Anmeldung	nationale Anmeldung		internationale Anmeldung:
(Tag/Monat/Jahr)		Staat *	regionales Amt	Anmeldeamt
Zeile (1) 1	.00 33 589.6	Bundesrepublik		
11. Juli 2000		Deutschland		
(11.7.00)				
Zeile (2)	i.d.			
				_
Zeile (3)				<u> </u>
Zene (3)				
Das Anmeldeamt wird ersu	icht eine beglaubig	te Abschrift der ob	en in Zeile(n) (1)	
bezeichneten früheren Anme				1.
<u></u>	LE RECHERCHE			
Wahl der Internationalen Recherchent			der Ergebnisse einer frühere	en Recherche: Bezugnahme auf
(falls zwei oder mehr als zwei Internatio	nale Recherchenbehörd		rche (falls eine frühere Recher	
für die Ausführung der internationalen l			beantragt oder von ihr durchge	
geben Sie die von Ihnen gewählte Behöre Zweibuchstaben-Code kann benützt werd	•	Datum (Tag/Monat/	Jahr): Aktenzeichen Staat	(oder regionales Amt)
ISA/	ien)			
	STE; EINREICHUN	NGSSPRACHE		
Diese internationale Anmeldung enth			ig liegen die nachstehend an	gekreuzten Unterlagen bei:
die folgende Anzahl von Blättern:				80.1.0.1. 0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
	1.🗵	Blatt für die Gebühre	nberechnung	
Antrag : 4 Blätt	ter 2.	Gesonderte unterzeio	hnete Vollmacht	
		Gesonaerte anterzere	mete vomnacht	
Beschreibung (ohne	3.	Kopien der allgemein	ien Vollmacht; Aktenzeiche	n (falls vorhanden)
Sequenzprotokollteil): 10 Blätt	ter	D	r.11	
Ansprüche : 3 Blätt	ter 4. L_	Begrundung für das	Fehlen einer Unterschrift	
, alspiration () 2 (als	5.	Prioritätsbeleg(e), in	Feld VI durch	
Zusammenfassung: 1 Blätter		folgende Zeilennumi	ner gekennzeichnet:	
	6.	Übersetzung der inte	mationalen Anmeldung in d	ie folgende Sprache:
Zeichnungen : 1 Blätt	ter			
Sequenzprotokollteil	7.		zu hinterlegten Mikroorgan	ismen oder biologischem
der Beschreibung : <u>Blätt</u>	ter	Material		
	8.	Sequenzprotokolle fi	ir Nucleotide und/oder Anm	inosäuren (Diskette)
Blattzahl insgesamt : 19 Blätt	ter			
	9. 🖂	Sonstige (einzeln au)		
		Abschrift für Priobel		
Abbildung der Zeichnungen, die		Sprache, in der		
mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): 1		internationale A eingereicht wird		
Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT	DEC ANMELDED			
Der Name jeder unterzeichnenden Po				form sich dies nicht eindeutig a
dem Antrag ergibt, in welcher Eigen:			en, una es isi anzageven, so	jern sich dies nicht eindeutig di
	none of the second seco		0 -	-
ROBERT BOSCH GMBH		1	1.	> \
Nr. 19/95 AV	~ 77			1.1. 1/0.0
///	Mac 1		frans-	I'm I'm
" /She	VIUIZT	which		
Brix	Pannek, Thor	rsten	Trah.	Hans-Peter
		·		
	Vo	m Anmeldeamt auszuft	illen	
1. Datum des tatsächlichen Eingangs	dieser			2. Zeichnungen
internationalen Anmeldung		•		1

Vom Anmeldeamt auszufüllen

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung

3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:

4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT:

5. Vom Anmelder benannte Internationale Recherchenbehörde: ISA/

6. Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchengebühr aufgeschoben

Vom Internationalen Büro auszufüllen



Datum des Eingangs des Aktenexemplars

(12) NACH DEM VERTRAS UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN RBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Januar 2002 (17.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/04905 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G01J 5/12

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/02145

G01K 7/02,

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. Juni 2001 (07.06.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 33 589.6

11. Juli 2000 (11.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PANNEK, Thorsten [DE/DE]; Hasenbergstrasse 99, 70176 Stuttgart (DE). TRAH, Hans-Peter [DE/DE]; Kullenbergstrasse 40, 70195 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

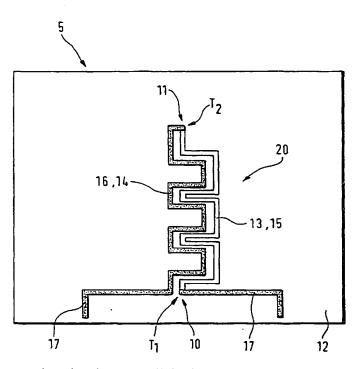
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MICROSTRUCTURED THERMOSENSOR

(54) Bezeichnung: MIKROSTRUKTURIERTER THERMOSENSOR



- (57) Abstract: The invention relates to a microstructured thermosensor (5), especially an infrared sensor, which has a support body (12) and at least one thermoelement (20) which is located thereon. Said thermoelement (20) has a first material (13) and a second material (14) which together form at least one thermocontact (10, 11), at least at points. The invention also provides that the first and/or second material (13, 14) is configured in the form of a square-wave or wave-shaped strip conductor (15, 16), at least in areas, and that these are guided on the support body (12). The invention also relates to a microstructured thermosensor (5) comprising strip conductors (15, 16) which are preferably also structured in this way, the first material (13) being platinum or aluminum and the second material (14) being doped or non-doped poly-silicon-germanium
- (57) Zusammenfassung: Es wird ein mikrostrukturierter Termosensor (5), insbesondere ein Infrarot-Sensor, vorgeschlagen, der einen Tragkörper (12) und mindestens ein darauf befindliches Thermoelement (20) aufweist. Das Thermoelement (20) weist weiter ein erstes Material (13) und ein zweites Material (14) auf, die zumindest punktuell mindestens einen Thermokontakt (10, 11) miteinander bilden. Weiter ist

vorgesehen, dass das erste und/oder das zweite Material (13, 14) zumindest bereichsweise in Form einer mäanderförmigen oder wellenförmigen Leiterbahn (15, 16) ausgebildet und auf dem Tragkörper (12) geführt sind. Daneben wird ein mikrostrukturierter Thermosensor (5) mit bevorzugt ebenfalls derart strukturierten Leiterbahnen (15, 16) vorgeschlagen, bei dem das erste Material (13) Platin oder Aluminium und das zweite Material (14) dotiertes oder undotiertes poly-Silizium-Germanium ist.

WO 02/04905

5

Mikrostrukturierter Thermosensor

10

20

25

30

35

Die Erfindung betrifft einen mikrostrukturierten Thermosensor, insbesondere einen Infrarot-Sensor, nach der Gattung der unabhängigen Ansprüche.

15 Stand der Technik

Bekannte Infrarot-Sensoren, wie sie beispielsweise in der Sicherheitstechnik, der Anlagentechnik oder der Hausgerätetechnik eingesetzt werden, messen die Temperatur eines Körpers anhand der von ihm ausgesandten Infrarot-Strahlung. Grundsätzlich unterscheidet man dabei sogenannte pyroelektrische, bolometrische sowie thermoelektrische Sensoren.

Im Fall der thermoelektrischen Sensoren ist bekannt, diese in Dünnschichttechnik beispielsweise auf Polyimid-Folie zu realisieren. Weiter sind auch bereits mikrostrukturierte Thermosensoren auf Basis der Silizium-Technik bekannt.

So wurde in der Anmeldung DE 199 32 308.9 vorgeschlagen, einen Thermosensor in Form einer auf einer zumindest weitgehend freitragenden Membran angeordneten Thermosäule herzustellen, wobei die Thermokontakte dieser Thermosäule abwechselnd in Form von "heißen" und "kalten" Thermokontakten ausgebildet und mit entsprechenden Kontaktsäulen mit einem Tragkörper verbunden und darüber auch elektrisch ansteuerbar

WO 02/04905 PCT/DE01/02145

- 2 -

sind. Weiter wurde darin vorgeschlagen, die auf der Oberfläche der weitgehend freitragenden Membran verlaufenden Thermoelemente in Form von Leiterbahnen zu realisieren, die abwechselnd aus einem ersten und einem zweiten Material gebildet werden, so dass in dem Bereich, in dem sich diese beiden Materialien berühren, Thermokontakte entstehen. Das erste Material ist dabei Aluminium während als zweites Material poly-Silizium eingesetzt wird.

5

10

15

20

25

30

35

In der Anmeldung DE 100 09 593.3 ist vorgeschlagen worden, einen mikrostrukturierten Thermosensor in Form eines Infrarot-Sensors auszuführen, indem auf einem Silizium-Substrat, beispielsweise mit Hilfe einer Opferschichttechnik oder eines anderen Ätzverfahrens, zunächst eine dünne freitragende Membran erzeugt wird, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit von einem darunter befindlichen Substrat thermisch entkoppelt ist, so dass sich die Membran bei Einfall von Infrarot-Strahlung stärker als das Substrat erwärmt. Auf der Membran befinden sich dann eine Vielzahl von mikrostrukturierten Sensorelementen bzw. Thermoelementen, die eine Temperaturdifferenz zwischen der Mitte der Membran und dem Substrat thermoelektrisch in ein dazu proportionales elektrisches Signal wandeln. Für die auf der freitragenden Membran in Form von Leiterbahnen realisierten Thermoelemente werden gemäß DE 100 09 593.3 die Materialkombinationen Platin/poly-Silizium, Aluminium/poly-Silizium oder p-dotiertes poly-Silizium/n-dotiertes poly-Silizium eingesetzt. Die Materialkombination poly-Silizium/Aluminium, die vor allem in der Bulk-Mikromechanik eingesetzt wird, hat dabei den Vorteil, dass sie CMOS-kompatibel ist.

Schließlich ist bekannt, dass als Materialien für Thermoelemente auch Gold, Antimon, Wismut und Bleitelluride eingesetzt werden können, wobei Gold sich auch für die Bulk-Mikromechanik eignet.

PCT/DE01/02145

Aufgabe der vorliegenden Erfindungen war die Realisierung eines gegenüber bekannten mikrostrukturierten Thermosensoren hinsichtlich Empfindlichkeit und der Stabilität bei höheren Temperaturen verbesserten mikrostrukturierten Thermosensors.

- 3 -

Vorteile der Erfindung

WO 02/04905

Der erfindungsgemäße mikrostrukturierte Thermosensor hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass durch die Struktur der auf dem Tragkörper befindlichen Leiterbahnen und/oder die spezielle Wahl der Materialien für das Thermoelement eine erhöhte Temperaturempfindlichkeit erreicht wird, ohne dass dazu wesentliche Änderungen des bisherigen Herstellungsverfahrens für mikrostrukturierte Thermosensoren erforderlich sind. Insbesondere wird erfindungsgemäß lediglich das Layout der erzeugten Leiterbahnen der Thermoelemente und/oder das zur Abscheidung dieser Leiterbahnen eingesetzte Material modifiziert.

20

25

15

5

10 .

Weiter ist vorteilhaft, dass durch die Wahl der Materialien für das Thermoelement, das heißt die Materialkombination Platin oder Aluminium mit dotiertem oder undotiertem poly-Silizium-Germanium, erreicht wird, dass der hergestellte mikrostrukturierte Thermosensor eine deutlich erhöhte Temperaturstabilität gegenüber bekannten Thermosensoren aufweist, bei denen beispielsweise Aluminium mit poly-Silizium als Material für das Thermoelement verwendet werden.

30

35

Zudem kann durch die Wahl der Materialien für das Thermoelement nun auch vermieden werden, dass bei Temperaturen größer als 200°C Migrationseffekte und damit Stabilitätsprobleme des erhaltenen mikrostrukturierten Thermosensors auftreten, wie dies vielfach bei Sensoren auf Basis von poly-Silizium und Aluminium als Thermoelementmaterial der Fall ist.

WO 02/04905 PCT/DE01/02145

_ 4 _

Darüber hinaus ist das bisher vielfach eingesetzte Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter, was bedeutet, dass die thermo-elektrische Effektivität des damit hergestellten Thermoelementes relativ niedrig ist, wohingegen Platin einerseits bei Temperaturen bis 400°C einsetzbar ist, und andererseits gegenüber Aluminium eine um den Faktor 3 niedrigere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Zudem zeigt auch polykristallines, dotiertes oder undotiertes poly-Silizium-Germanium im Gegensatz zu polykristallinem Silizium eine um den Faktor 3 bis 8 niedrigere Wärmeleitfähigkeit und führt daher ebenfalls zu einer deutlich erhöhten thermoelektrischen Effektivität des hergestellten Thermoelementes.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus dem in den Unteransprüchen genannten Maßnahmen.

So wird insbesondere durch eine Kombination des neuartigen, mäanderförmigen oder wellenförmigen Layouts der mikrostrukturierten Leiterbahnen auf der Oberfläche des Tragkörpers mit den erläuterten, speziellen Materialien für das Thermoelement eine besonders hohe Empfindlichkeitssteigerung und besonders gute Temperaturstabilität des Thermosensors erreicht.

25

30

35

5

10

15

20

Vorteilhaft ist weiter, dass je nach Anwendung des mikrostrukturierten Thermoelementes, beispielsweise als Infrarot-Sensor, die genannten Materialien für das Thermoelement untereinander kombinierbar sind, wobei das Halbleitermaterial p-dotiert oder n-dotiert sein kann.

Da bei mikrostrukturierten Thermosensoren eine Temperaturdifferenz zwischen sogenannten "heißen" und "kalten" Kontakten thermoelektrisch in eine messbare elektrische Spannung gewandelt wird, müssen die "kalten" Stellen entweder auf eiWO 02/04905 PCT/DE01/02145

- 5 -

ner konstanten Temperatur gehalten werden, oder diese Temperatur muss gegenüber der Temperatur des "heißen" Kontaktes bekannt bzw. referenziert sein. Üblicherweise werden dazu bisher sogenannte Thermistoren in Hybridtechnik auf dem Tragkörper für das Thermoelement integriert, da die eingesetzten Materialien Aluminium und poly-Silizium zum Bestimmen dieser Referenztemperatur vielfach nicht empfindlich genug sind.

5

10

15

20

25

30

35

Bei der Verwendung von Platin als thermoelektrisches Material ist es in diesem Zusammenhang nunmehr weiter vorteilhaft möglich, ein hochpräzises, resistives Temperaturmesselement im gleichen Herstellungsschritt wie die entsprechende Leiterbahn bzw. Zuleitung mit auf dem Silizium-Chip beziehungsweise dem das Thermoelement tragenden Tragkörper zu integrieren bzw. abzuscheiden. Somit erübrigt sich ein zusätzlicher Thermistor.

Die Ausführung der Leiterbahnen in Form von mäanderförmigen oder wellenförmigen, auf dem Tragkörper verlaufenden Leiterbahnen bietet weiter die Möglichkeit, nur die Leiterbahn mit dem niedrigeren Innenwiderstand als Mäander auszuführen, da es bei einem Material mit einem hohen elektrischen Widerstand durch die Mäanderform bzw. Wellenform zu einer erhöhten Rauschspannung kommt.

Weiter sei betont, dass die mäanderförmigen bzw. wellenförmigen Leiterbahnen sowohl nebeneinander verlaufend als auch zumindest bereichsweise überlappend oder übereinander verlaufend ausgeführt sein können, wobei diese dann durch geeignete Isolationsschichten aus beispielsweise Oxiden elektrisch isolierend voneinander getrennt sein müssen. Sofern ausreichend Fläche zur Verfügung steht, ist es in der Regel vorteilhaft, die Leiterbahnen nebeneinander zu führen.

Schließlich ist es nun in einfacher Weise möglich, die Empfindlichkeit des erhaltenen mikrostrukturierten Thermosensors auch dadurch zu variieren bzw. zu steigern, indem man die Anzahl der Wellen bzw. Mäander variiert. Dabei macht man sich zunutze, dass mit zunehmender Länge einer Leiterbahn deren Wärmewiderstand zunimmt, d. h. der Wärmewiderstand einer mäanderförmigen Leiterbahn ist größer als der einer entsprechenden Geraden.

10 Zeichnungen

WO 02/04905

Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und in den nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Die Figur zeigt ein
einzelnes, auf der Oberfläche eines Tragkörpers in Form von
aufgebrachten, nebeneinander verlaufenden Leiterbahnen erzeugtes Thermoelement.

Ausführungsbeispiele

Die Erfindung geht im erläuterten Ausführungsbeispiel zunächst von einem Infrarot-Sensor aus, wie er in der Anmeldung DE 100 09 593.3 bereits vorgeschlagen worden ist. Der
dort vorgeschlagene Infrarot-Sensor wird jedoch in zweierlei
Hinsicht modifiziert.

25

30

35

15

5

Im Einzelnen wird zunächst auf einem gut wärmeleitenden Material wie Silizium als Substrat, wie bereits in DE 100 09 593.3 vorgeschlagen, eine zumindest weitgehend freitragende Membran aus einem schlecht wärmeleitenden Material wie beispielsweise einem Oxid, einem Nitrid oder einer Kombination beider Materialien erzeugt. Bevorzugt besteht diese zumindest weitgehend freitragende Membran, die im Weiteren dann als Tragkörper 12 für ein darauf aufzubringendes Thermoelement 20 dient, dabei aus Siliziumdioxid, Siliziumnitrid oder aus porösem Silizium.

WO 02/04905

5

10

15

20

25

30

35

Danach werden auf der Oberfläche dieses Tragkörpers 12 eine Vielzahl von in Serie geschalteten, kreuzförmig oder sternförmig angeordneten Thermoelementen 20 erzeugt, wobei gemäß der Figur, die lediglich ein einzelnes dieser Thermoelemente 20 zeigt, vorgesehen ist, dass auf dem Tragkörper 12 zunächst ein erstes Material 13 in Form einer ersten, mäanderförmigen Leiterbahn 15 und anschließend ein zweites Material 14 in Form einer zweiten, ebenfalls mäanderförmigen Leiterbahn 16 abgeschieden wird. Die erste Leiterbahn 15 und die zweite Leiterbahn 16 verlaufen dabei, wie in der Figur dargestellt, zumindest weitgehend parallel nebeneinander.

Weiter ist vorgesehen, dass sich das erste Material 13 und das zweite Material 14 im Bereich eines ersten Thermokontaktes 10 und eines zweiten Thermokontaktes 11 berühren, und dass weiter Zuleitungen 17 zu dem Thermoelement 20 vorgesehen sind, die analog der zweiten Leiterbahn 16 ausgebildet und aufgebracht worden sind, so dass das Thermoelement 20 über diese Zuleitungen 17 elektrisch in an sich bekannter Weise mit nicht dargestellten elektronischen Bauelementen verschaltet bzw. angesteuert werden kann.

In der Figur ist weiter dargestellt, dass der erste Thermokontakt 10 einer ersten Temperatur T_1 und der zweite Thermokontakt 11 einer zweiten Temperatur T_2 ausgesetzt ist. Dabei ist die Temperatur T_2 die eigentliche, von dem mikrostrukturierten Thermosensor 5 zu detektierende bzw. zu messende Temperatur, während die Temperatur T_1 entweder zumindest näherungsweise konstant gehalten wird oder alternativ mittels einer zusätzlichen Messeinrichtung bestimmbar ist. Insofern dient die Temperatur T_1 des ersten Thermokontaktes 10 ("kalter" Thermokontakt) als Referenztemperatur für die zu messende Temperatur T_2 des zweiten Thermokontakt 11 ("heißer" Thermokontakt).

WO 02/04905 PCT/DE01/02145

- 8 -

Die Breite der Leiterbahnen 14, 15 und der Zuleitungen 17 liegt im Übrigen zwischen 20 nm und 200 µm, bevorzugt zwischen 1 µm bis 20 µm. Ihre Dicke beträgt 10 nm bis 10 µm, bevorzugt 100 nm bis 2 µm. Das Erzeugen der ersten bzw. zweiten Leiterbahn 15, 16 sowie deren mäanderförmige Strukturierung, und das Erzeugen der Zuleitungen 17 erfolgte in bekannter Weise durch Aufsputtern oder Aufdampfen der jeweiligen Materialien 13, 14, beispielsweise mittels PECVD ("Physically Enhanced Chemical Vapour Deposition").

5

10

15

20

25

30

35

Konkret ist im erläuterten Ausführungsbeispiel das erste Material 13 n-dotiertes poly-Silizium-Germanium mit einer Wärmeleitfähigkeit von 3 bis 8 W/Km. Das zweite Material 14 ist im erläuterten Beispiel Platin mit einer Wärmeleitfähigkeit von 70 W/Km. Darüber hinaus sind auch die Zuleitung 17 jeweils analog der zweiten Leiterbahn 16 in Form einer Platinleiterbahn ausgeführt, so dass sich zwei Thermokontakte 10, 11 ergeben, die jeweils von der Materialkombination Platin/poly-Silizium-Germanium gebildet werden.

Alternativ zu dem erläuterten Ausführungsbeispiel gemäß der Figur kann auch vorgesehen sein, dass die erste Leiterbahn 14 und die zweite Leiterbahn 15 bereichsweise oder vollständig übereinander verlaufen, und, abgesehen von den Thermokontakten 10, 11, elektrisch voneinander isoliert geführt sind. Die elektrische Isolation wird in diesem Fall durch eine oxidische, elektrisch isolierende Zwischenschicht zwischen den Leiterbahnen 15, 16 gewährleistet.

Weiter ist offensichtlich, dass an Stelle von zwei Thermokontakten 10, 11 auch eine Mehrzahl von Thermokontakten vorgesehen sein kann, die nach Art einer Thermokette oder einer Thermosäule angeordnet sind. Dabei sind dann mindestens zwei 5

10

15

20

25

30

35

der Thermokontakte unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung wird in Weiterführung des ersten Ausführungsbeispiels zusätzlich ein Teil einer zusätzlichen Messeinrichtung in Form einer Leiterbahn zu Bestimmung der ersten Temperatur T_1 auf dem Tragkörper 12 erzeugt bzw. integriert. Damit kann dann auf die Integration eines üblichen Thermistors auf der Oberfläche des Tragkörpers 12 im Bereich des ersten Thermokontaktes 10 verzichtet werden.

Im Einzelnen ist diese Messeinrichtung dann dadurch realisiert, dass in einer Umgebung des ersten Thermokontaktes 10 eine zusätzliche Referenzleiterbahn aus Platin als sensitives Bauteil dieser Messeinrichtung vorgesehen ist, die über entsprechende Zuleitungen ebenfalls mit an sich bekannten Auswertemitteln zur Bestimmung eines temperaturabhängigen elektrischen Widerstandes dieser Referenzleiterbahn verschaltet ist. Diese Referenzleiterbahn ist dabei beispielsweise analog der Zuleitung 17 oder der zweiten Leiterbahn 16 ausgeführt.

Alternativ kann diese Messeinrichtung jedoch auch dadurch realisiert sein, dass ein Abschnitt der zweiten Leiterbahn 16 oder der Zuleitungen 17 als Referenzleiterbahn genutzt wird und mit entsprechenden Auswertemitteln zur Bestimmung des Temperatur abhängigen elektrischen Widerstandes dieses Teils der Leiterbahn verschaltet ist.

Diese Möglichkeit der Integration einer zusätzlichen Referenzleiterbahn auf dem Tragkörper 12 bzw. die Möglichkeit der Nutzung eines Teiles der zweiten Leiterbahn 16 oder der Zuleitung 17 als Referenzleiterbahn auf dem Tragkörper 12 zur Messung bzw. Überwachung der Temperatur T1 ergibt sich

WO 02/04905 PCT/DE01/02145

- 10 -

aus der Eignung von Platin zur hochpräzisen resistiven Temperaturmessung.

5

10

Hinsichtlich weiterer Details zum Aufbau des Thermoelementes 20 und der Funktion und dem weiteren Aufbau des Thermoelementes 5 gemäß der Figur sei auf die Anmeldung DE 100 09 593.3 verwiesen, in der dieser Thermosensor 5, abgesehen von dem speziellen Layout der Leiterbahnen 15, 16 des Thermoelementes 20 und der speziellen Wahl der Materialien für das Thermoelement 20, in Form eines Infrarot-Sensors beschrieben ist.

WO 02/04905 PCT/DE01/02145

- 11 -

5

Ansprüche

10

15

1. Mikrostrukturierter Thermosensor, insbesondere Infrarot-Sensor, mit einem Tragkörper und mindestens einem darauf
befindlichen Thermoelement, das ein erstes Material und ein
zweites Material aufweist, die zumindest punktuell mindestens einen Thermokontakt miteinander bilden, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/oder das zweite Material
(13, 14) zumindest bereichsweise in Form einer mäanderförmigen oder wellenförmigen Leiterbahn (15, 16) ausgebildet und
auf dem Tragkörper (12) geführt ist.

20

2. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Material (13) und das zweite Material (14) in Form von zumindest weitgehend nebeneinander verlaufenden, abgesehen von den Thermokontakten (10, 11) elektrisch voneinander isolierten Leiterbahnen (15, 16) oder in Form von zumindest bereichsweise übereinander verlaufenden, abgesehen von den Thermokontakten (10, 11) elektrisch voneinander isolierten Leiterbahnen (15, 16) geführt ist.

30

25

3. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Thermoelement (20) eine Mehrzahl von Thermokontakten (10, 11) aufweist, die nach Art einer Thermokette oder einer Thermosäule angeordnet sind,

5

10

wobei mindestens zwei der Thermokontakte (10, 11) unterschiedlichen Temperaturen (T_1 , T_2) ausgesetzt sind.

- 4. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein einer zu detektierenden oder zu messenden zweiten Temperatur (T_2) ausgesetzter zweiter Thermokontakt (11) und ein einer zumindest näherungsweise konstant gehaltenen oder konstanten ersten Temperatur (T_1) ausgesetzter erster Thermokontakt (10) vorgesehen ist, wobei insbesondere weiter vorgesehen ist, dass die erste Temperatur (T_1) mittels einer zusätzlichen Messeinrichtung bestimmbar ist.
- 5. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung einen in einer Umgebung des ersten Thermokontaktes (10) befindlichen
 Teil einer der Leiterbahnen (15, 16) oder einer der Zuleitungen (17) oder eine in einer Umgebung des ersten Thermokontaktes (10) befindliche Referenzleiterbahn als sensitives
 Bauteil sowie Auswertemittel zur Bestimmung eines temperaturabhängigen elektrischen Widerstandes des Teils der Leiterbahn (15, 16), der Zuleitung (17) oder der Referenzleiterbahn aufweist.
- 6. Mikrostrukturierter Thermosensor nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/oder das zweite Material (13, 14) ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit ist.
- 7. Mikrostrukturierter Thermosensor nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und das zweite Material (13, 14) aus der Gruppe Platin, Gold, den Bleitelluriden, Aluminium, Titan, poly-Silizium, dotiertes poly-Silizium, poly-Silizium-

5

10

25

30

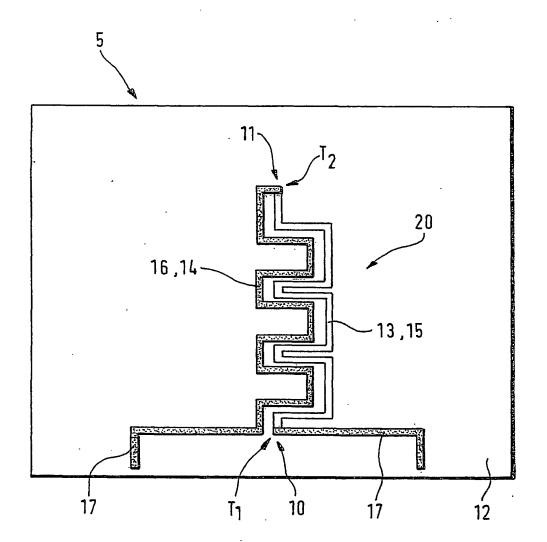
- 13 -

Germanium oder dotiertes poly-Silizium-Germanium ausgewählt ist.

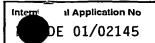
- 8. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Material (14) Platin und das erste Material (13) dotiertes oder undotiertes poly-Silizium-Germanium ist.
- 9. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 5 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil der Leiterbahn (15, 16), der Zuleitung (17) oder der Referenzleiterbahn eine Platinleiterbahn ist.
- 10. Mikrostrukturierter Thermosensor, insbesondere Infrarot-Sensor, mit einem Tragkörper und mindestens einem darauf
 befindlichen Thermoelement, das ein erstes Material und ein
 zweites Material aufweist, die zumindest punktuell mindestens einen Thermokontakt miteinander bilden, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Material (14) Platin oder Aluminium und das erste Material (13) dotiertes oder undotiertes poly-Silizium-Germanium ist.
 - 11. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/oder das zweite Material (13, 14) zumindest bereichsweise in Form einer mä-anderförmigen oder wellenförmigen Leiterbahn (15, 16) ausgebildet und auf dem Tragkörper (12) geführt ist.
 - 12. Mikrostrukturierter Thermosensor nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Thermoelement (20) eine Mehrzahl von Thermokontakten (10, 11) aufweist, die nach Art einer Thermokette oder einer Thermosäule angeordnet sind, wobei mindestens zwei der Thermokontakte (10, 11) unterschiedlichen Temperaturen (T_1 , T_2) ausgesetzt sind.

Ċ.

1)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01K7/02 G01C G01J5/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G01K G01J H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	Relevant to claim No.
Α	US 5 220 189 A (HIGASHI ROBERT 15 June 1993 (1993-06-15) column 5, line 30 - line 68; f		1,6
Α	WO 91 02229 A (BRAUN AG) 21 February 1991 (1991-02-21) abstract; figures		1,2
Α	FR 1 204 718 A (J. MICHEL) 27 January 1960 (1960-01-27) figure 1		1,6
A	US 5 695 283 A (JOHNSON BRUCE 9 December 1997 (1997-12-09) column 4, line 31 - line 57; f		1
		-/	
	·		
X Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are li	sted in annex.
"A" docume consid	tegories of cited documents: ant defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance locument but published on or after the international	"T" later document published after the or priority date and not in conflict cited to understand the principle of invention "X" document of particular relevance;	with the application but or theory underlying the

NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

Name and mailing address of the ISA

other means

document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

document referring to an oral disclosure, use, exhibition or

document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2

Date of the actual completion of the international search

29 August 2001

Date of mailing of the international search report

& document member of the same patent family

06/09/2001

Ramboer, P

in the art.

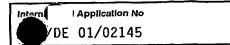
Authorized officer

cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the

document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



	1	/DE 01,	702145
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	EP 0 999 437 A (OPTO TECH CORP) 10 May 2000 (2000-05-10) column 6, line 5 - line 9; figures	·	1,4
A	GERWEN VAN P ET AL: "THIN-FILM BORON-DOPED POLYCRYSTALLINE SILICON 70%-GERMANIUM 30% FORTHERMOPILES" SENSORS AND ACTUATORS A, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, vol. A53, no. 1/3, 1 May 1996 (1996-05-01), pages 325-328, XP000620316 ISSN: 0924-4247 the whole document		6,8,10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

n on patent family members

Intern	al Application No
	DE 01/02145

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5220189 A	15-06-1993	EP 0645056 A WO 9326053 A	29-03-1995 23-12-1993
WO 9102229 A	21-02-1991	DE 3925391 A DE 4091364 A DE 4091364 D EP 0485401 A	07-02-1991 30-01-1992 30-01-1992 20-05-1992
FR 1204718 A	27-01-1960	CH 337888 A DE 1205598 B	30-04-1959
US 5695283 A	09-12-1997	NONE	
EP 0999437 A	10-05-2000	NONE	